

2006年2月7日



2006年3月期第3四半期財務・業績の概況

東レ株式会社
代表取締役社長 榊原定征

目次

・2006年3月期第3四半期連結業績の概要

- ・連結業績の概要 (P 4 ~ 5)
- ・事業セグメント別業績の概要 (P 6 ~ 7)
- ・事業セグメント別業績 (P 8 ~ 14)
- ・営業利益増減要因分析 (P 15)

・2006年3月期通期業績見通し

- ・連結業績見通し (P 17)
- ・事業セグメント別業績見通し (P 18)
- ・原料価格の見通し (P 19)

・最近のトピックス (P 21 ~ 22)

< 参考資料 > (P 24 ~ 30)

・2006年3月期第3四半期連結業績の概要

連結業績の概要(第3四半期まで累計)

億円

蝶理・水道機工の上期の影響を除いた場合

	05年3月期 (4-12月累計)	06年3月期 (4-12月累計)	増減
売上高	9,119	10,265	+1,146 (+12.6%)
売上総利益	1,914	2,135	+222 (+11.6%)
(売上高総利益率)	21.0%	20.8%	-0.2 ポイント
販売費及び 一般管理費	1,412	1,557	+145 (+10.3%)
(売上高販管費比率)	15.5%	15.2%	-0.3 ポイント
営業利益	502	578	+76 (+15.2%)
(売上高営業利益率)	5.5%	5.6%	+0.1 ポイント
営業外収支	18	37	-19 (-)
経常利益	484	542	+57 (+11.8%)
特別損益	61	48	+12 (-)
税前利益	424	493	+70 (+16.4%)
純利益	268	280	+12 (+4.6%)

	05年3月期 (4-12月累計)	06年3月期 (4-12月累計)	増減
売上高	9,119	9,235	+116 (+1.3%)
売上総利益	1,914	2,033	+120 (+6.2%)
(売上高総利益率)	21.0%	22.0%	+1.0 ポイント
販売費及び 一般管理費	1,412	1,464	+53 (+3.7%)
(売上高販管費比率)	15.5%	15.9%	+0.4 ポイント
営業利益	502	569	+67 (+13.3%)
(売上高営業利益率)	5.5%	6.2%	+0.7 ポイント

(通期営業利益見通しに対する第3Qまで累計の進捗率)

	05年 3月期	06年 3月期
第3Qまで累計営業利益	502	578
通期営業利益 05年3月期は実績 06年3月期は見通し	811	920
第3Qまで累計の進捗率	62.0%	62.9%

(注) 3月期決算会社は4～12月の業績, 12月期決算会社は1～9月の業績を連結

連結業績の概要(第3四半期(10月~12月))

億円

	05年3月期 第3四半期	06年3月期 第3四半期	増減
売上高	3,362	3,477	+116 (+3.4%)
売上総利益	643	715	+72 (+11.2%)
(売上高総利益率)	19.1%	20.6%	+1.4 ポイント
販売費及び 一般管理費	497	525	+28 (+5.7%)
(売上高販管費比率)	14.8%	15.1%	+0.3 ポイント
営業利益	146	190	+44 (+30.0%)
(売上高営業利益率)	4.4%	5.5%	+1.1 ポイント
営業外収支	10	17	-7 (-)
経常利益	136	173	+37 (+27.1%)
特別損益	19	11	+30 (-)
税前利益	117	185	+67 (+57.5%)
純利益	70	112	+43 (+61.3%)

	05年9月末	05年12月末	増減	05年3月末 <ご参考>
総資産	14,226	14,911	+685 (+4.8%)	14,023
株主資本	4,844	5,051	+207 (+4.3%)	4,525
有利子負債	4,595	4,861	+266 (+5.8%)	4,668
D / E レシオ	0.95	0.96	+0.01	1.03

(注) 3月期決算会社は10~12月の業績、12月期決算会社は7~9月の業績を連結

事業セグメント別業績の概要(第3四半期まで累計)

億円

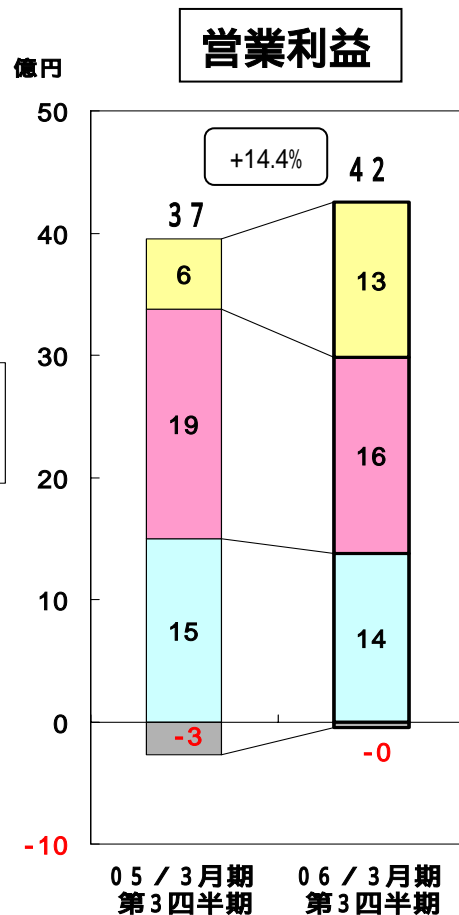
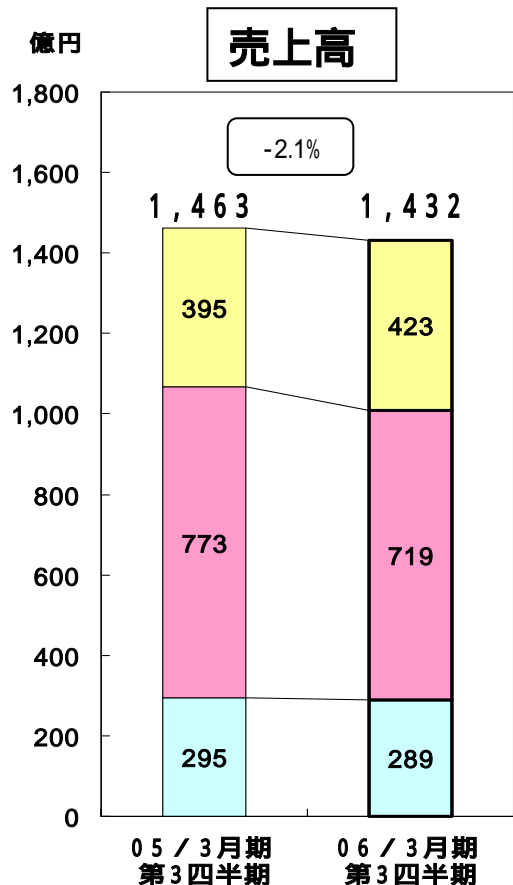
	売上高			営業利益		
	05年3月期 (4-12月累計)	06年3月期 (4-12月累計)	増減	05年3月期 (4-12月累計)	06年3月期 (4-12月累計)	増減
繊維	3,705	4,319	+614 (+16.6%)	137	146	+8 (+6.0%)
プラスチック・ケミカル	2,186	2,486	+300 (+13.7%)	98	133	+34 (+35.1%)
情報通信材料・機器	1,636	1,692	+57 (+3.5%)	212	198	-14 (-6.5%)
炭素繊維複合材料	327	380	+53 (+16.2%)	41	87	+46 (+114.2%)
環境・エンジニアリング	762	902	+140 (+18.3%)	7	8	-1 (-)
ライセンスその他	502	485	-17 (-3.4%)	19	26	+7 (+37.5%)
(内医薬・医療)	302	305	+4 (+1.3%)	3	9	+12 (-)
連結	9,119	10,265	+1,146 (+12.6%)	502	578	+76 (+15.2%)

事業セグメント別業績の概要(第3四半期(10月～12月))

億円

	売上高			営業利益		
	05年3月期 第3四半期	06年3月期 第3四半期	増減	05年3月期 第3四半期	06年3月期 第3四半期	増減
繊維	1,463	1,432	-31 (-2.1%)	37	42	+5 (+14.4%)
プラスチック・ケミカル	838	898	+60 (+7.2%)	38	46	+9 (+23.0%)
情報通信材料・機器	551	581	+30 (+5.4%)	62	67	+5 (+7.9%)
炭素繊維複合材料	112	136	+24 (+21.2%)	13	28	+16 (+124.3%)
環境・エンジニアリング	242	283	+41 (+16.7%)	10	4	+14 (-)
ライフサイエンスその他	155	148	-8 (-4.9%)	6	6	-0 (-2.3%)
(内医薬・医療)	99	102	+3 (+2.6%)	0	3	+2 (+800.0%)
連結	3,362	3,477	+116 (+3.4%)	146	190	+44 (+30.0%)

事業セグメント別業績(繊維)



特記事項

東レ

不採算品種の戦略的削減による販売量減少の影響もあり、減収。産業用途は堅調に推移したが、国内衣料用途需要は引き続き盛り上がりを欠き、微減益。

国内子会社

商事子会社が振るわず、減収減益。

海外子会社

東南アジアのポリエステル/綿混織物子会社が拡販を進めるとともに、中国の子会社も収益を改善し、増収増益。

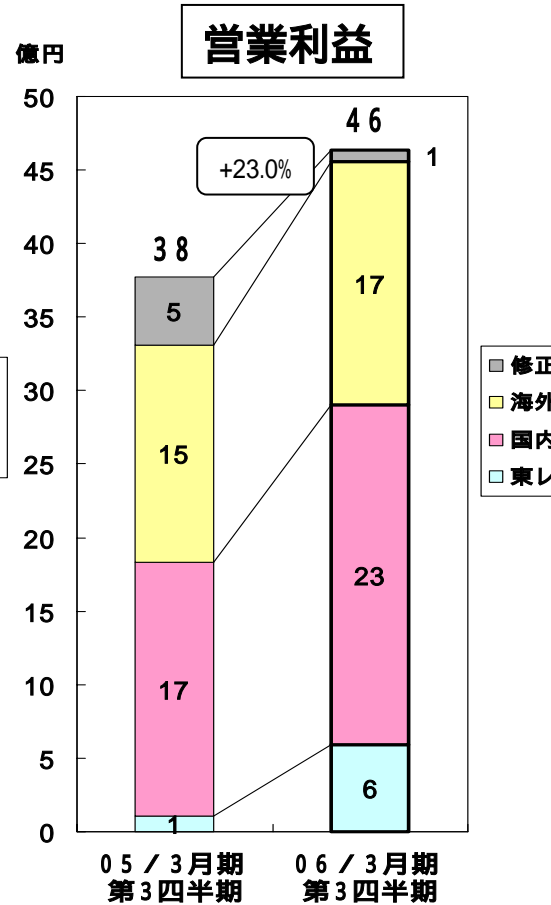
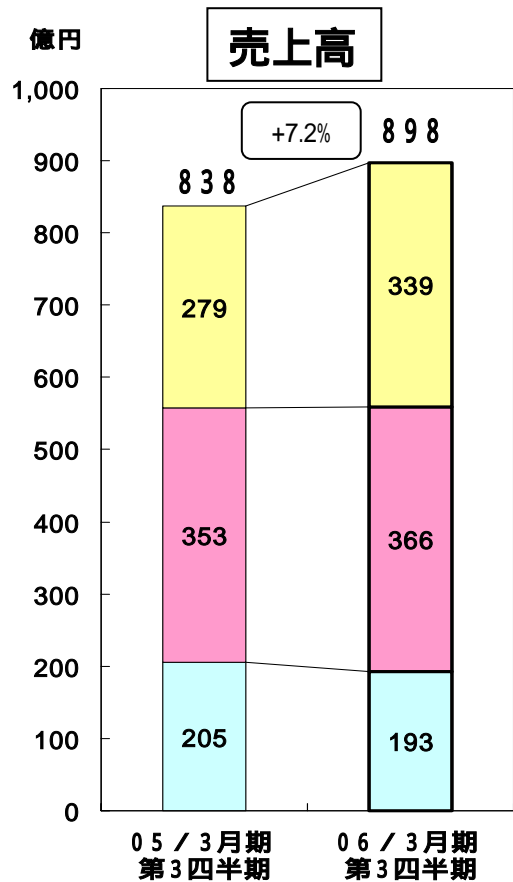
< 主要関係会社 >

国内: 東レインターナショナル、一村産業、蝶理 他

アジア: PENFABRIC(マレーシア)、LUCKYTEX(タイ)、ITS(インドネシア)、TFNL(中国) 他

欧米: ALCANTARA(イタリア) 他

事業セグメント別業績(プラスチック・ケミカル)



特記事項

東レ

樹脂事業は、主力の自動車用途を中心に堅調に推移したが、昨年度まで外部商社経由で販売していた中国向け樹脂ビジネスを子会社経由に変更したため、内部消去増で減収。フィルム事業は、工業材料用途で拡販を進め、東レ全体で増益。

国内子会社

商事子会社が拡販を進めるとともに、フィルム加工子会社も工業材料用途が順調に推移し、増収増益。

海外子会社

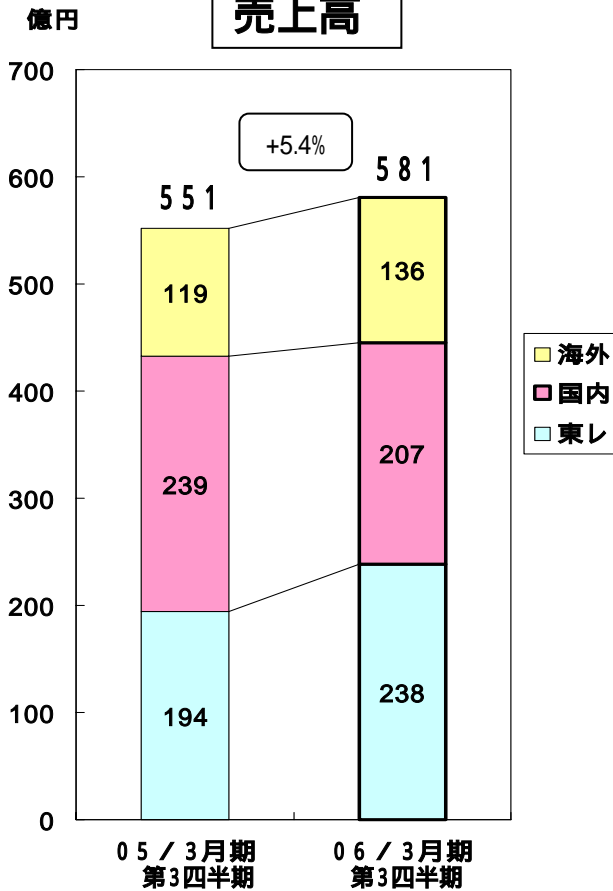
マレーシアの樹脂・フィルム各子会社が堅調に推移するとともに、昨年度まで外部商社経由であった中国向け樹脂ビジネスを香港の子会社が取り込むことにより、増収増益。

< 主要関係会社 >

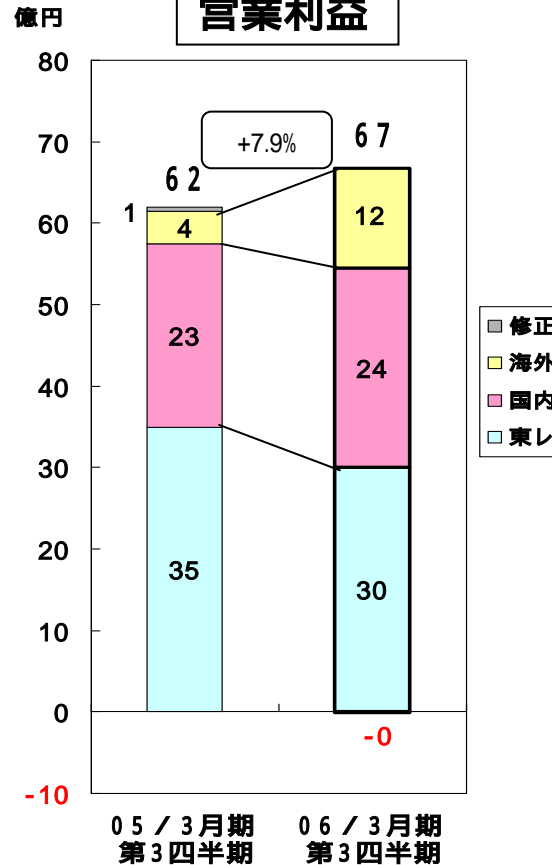
国内： 東レフィルム加工、東レ・ファインケミカル、曾田香料、蝶理 他
 海外： TPA(アメリカ)、TPM(マレーシア)、TPEu(フランス)、TSI(韓国) 他

事業セグメント別業績(情報通信材料・機器)

売上高



営業利益



特記事項

東レ

需要の拡大するIT家電向けに、IT関連樹脂・フィルム、回路材料、半導体材料等の拡販を進め増収なるも、光学用フィルムの増産準備に伴う開発費用の増加及び、携帯用LCD市場の競争激化によるカラーフィルター販売価格の低下等もあり、減益。

国内子会社

昨年需要が旺盛であったスリットコーターの需要一巡の影響で減収。一方、フィルム加工子会社はFPD用フィルムや回路材料の拡販を進め増収増益。国内子会社全体では、減収ながら増益。

海外子会社

韓国子会社がFPD用フィルムの拡販を進めるとともに、回路材料関連事業も好調に推移し、増収増益。

< 主要関係会社 >

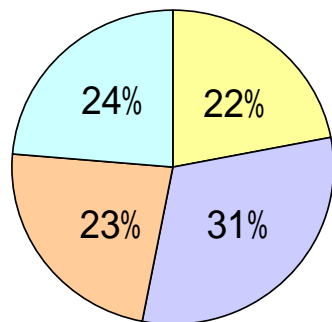
国内：東レエンジニアリング、東レフィルム加工 他

海外：TPA(アメリカ)、TPEu(フランス)、TSI(韓国) 他

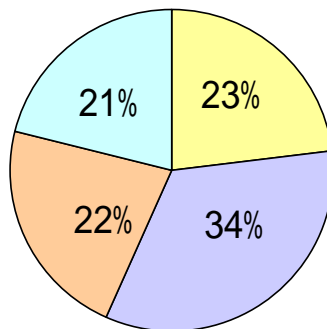
情報通信材料・機器セグメントの売上高の詳細 TORAY

【06年3月期サブセグメント別売上高比率】

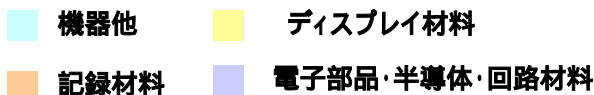
第3四半期まで累計
(第1Q～第3Q)



第3四半期(3ヶ月)



サブセグメント名



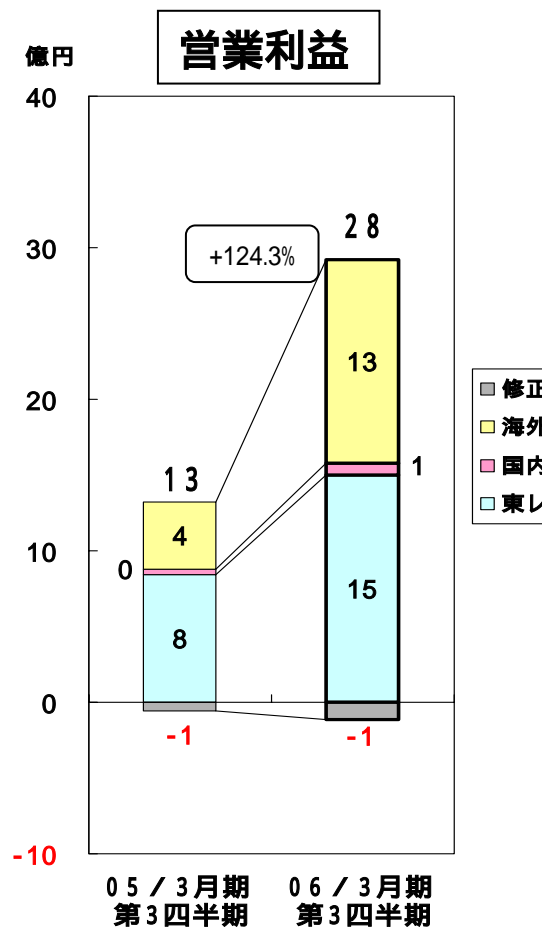
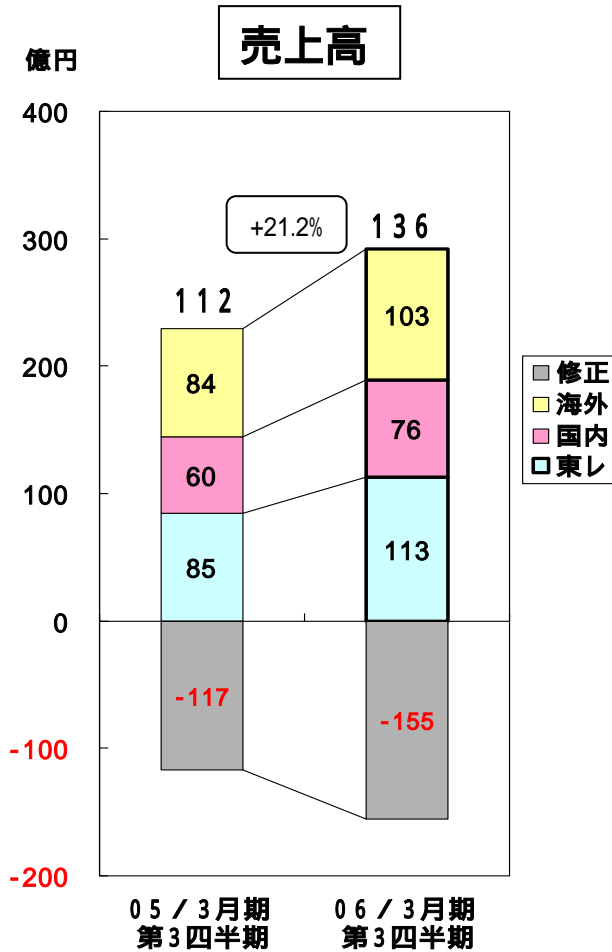
サブセグメント名	内訳
ディスプレイ材料	光学用フィルム、光学用フィルム加工品、PDPペースト、カラーフィルター、カラーフィルター用ペースト、ケミカル材料、有機EL材料他
電子部品・半導体・回路材料	電子部品・回路用フィルム、FPC用銅張ポリイミドフィルム、TAB用接着テープ、半導体・電子部品用接着シート、半導体コーティング材料、2層銅張ポリイミドフィルム、TABテープ・COF加工品、樹脂材料、樹脂加工品他
記録材料	磁気材料、TTR (Thermal Transfer Ribbon)・受容紙用フィルム、印刷システム材料他
機器他	液晶スリットコーター、ダイボンディング装置、検査装置、PDP用装置・部品、商社、システム、サービス他

【サブセグメント別売上高推移】

(単位: 億円)

サブセグメント	第3四半期まで累計			第3四半期(3ヶ月)		
	05年3月期	06年3月期	増減率	05年3月期	06年3月期	増減率
ディスプレイ材料	318	372	+17%	105	135	+29%
電子部品・半導体・回路材料	463	529	+14%	150	195	+30%
記録材料	398	392	-2%	128	129	+1%
機器他	457	400	-12%	168	122	-27%
情報通信材料・機器セグメント合計	1,636	1,692	+3%	551	581	+5%

事業セグメント別業績(炭素繊維複合材料)



特記事項

東レ

航空機用途に加え、機械部品・土木建築等産業用途が堅調に推移するとともに、需給タイトを背景としたゴルフシャフト等スポーツ用途の値戻しも進み、増収増益。

国内子会社

商事子会社が順調に拡販し、増収増益。

海外子会社

欧州子会社の増産・増販効果とともに、米国子会社も航空機用途を中心に拡販、アジアを含む各地域で高採算品へのシフトが進み、増収増益。

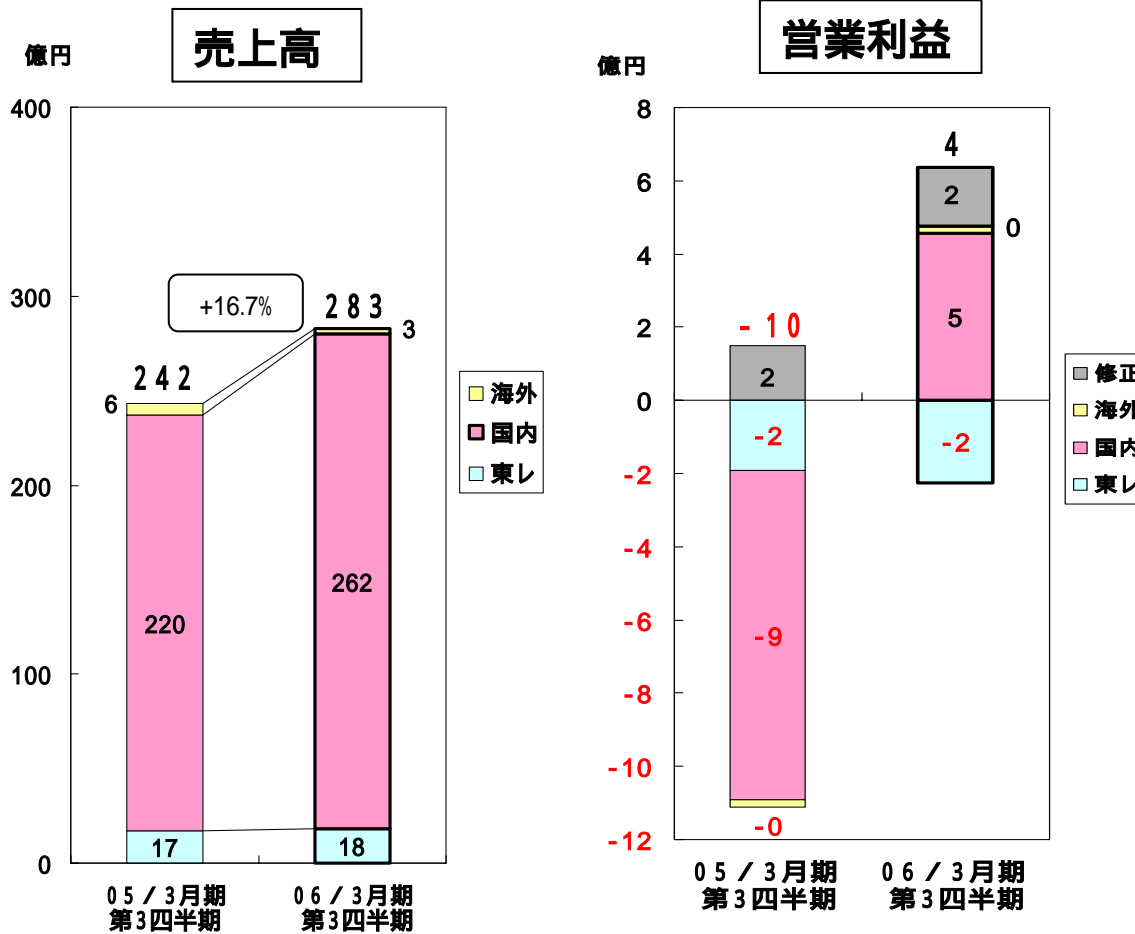
本セグメントでは、日米欧3拠点のグローバルオペレーションの規模が大き
く、実態を正しく表すために、内部売上高の消去を外枠で記載しています。

< 主要子会社 >

国内：東レインターナショナル

海外：SOFICAR (フランス) 他

事業セグメント別業績(環境・エンジニアリング) **TORAY**



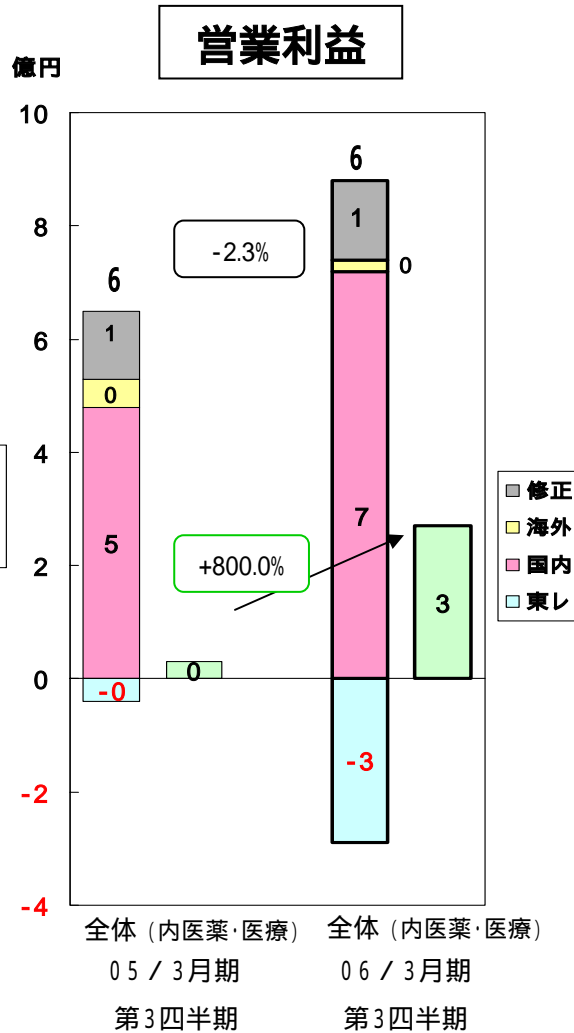
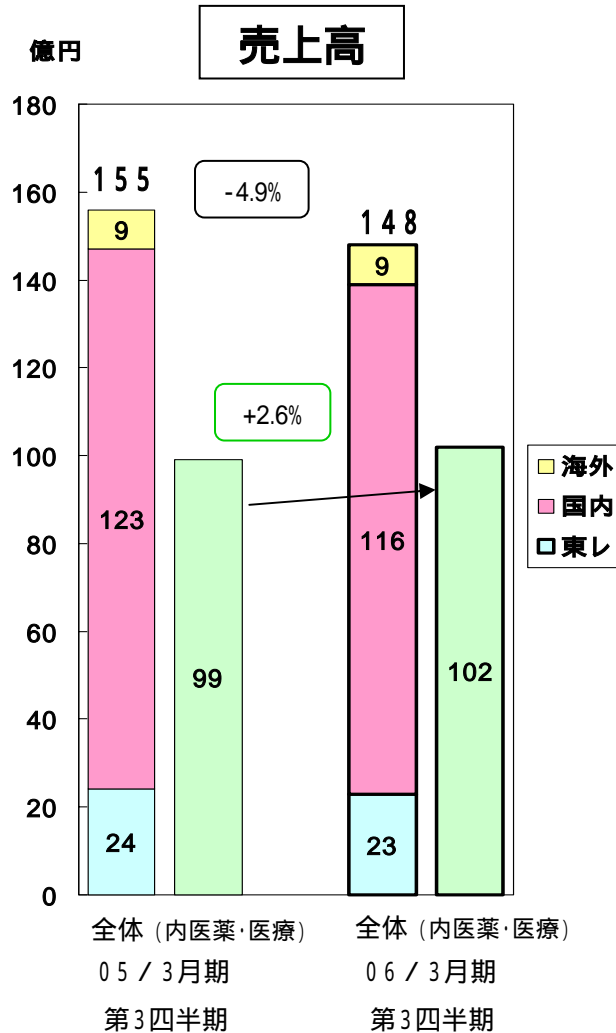
特記事項

国内子会社
 建設子会社・エンジニアリング子会社が拡販と体質強化を進め、増収増益。

< 主要子会社 >

国内：東レ建設、東レエンジニアリング、東レACE、水道機工 他

事業セグメント別業績(ライフサイエンスその他) **TORAY**



特記事項

東レ

医薬事業の競争激化の影響により、減収減益。

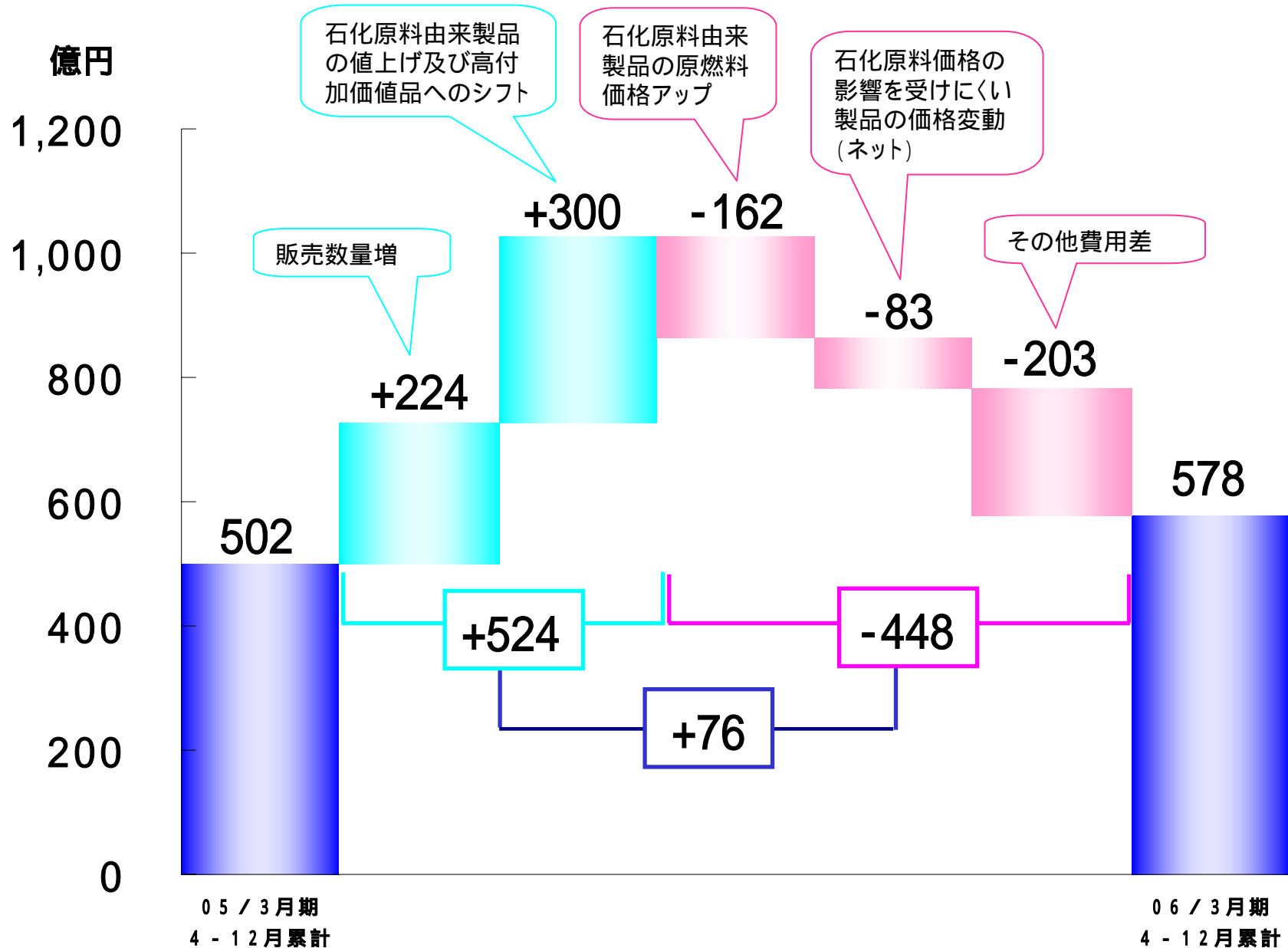
国内子会社

医療子会社は、拡販と体質強化を進め増収増益。昨年度にホテル事業を譲渡したこと等もあり、全体では減収増益。

< 主要関係会社 >

国内：東レ・メディカル、東レリサーチセンター、東レエンタープライズ 他

営業利益増減要因分析(第3四半期まで累計)



2006年3月期通期業績見通し

連結業績見通し

億円

	前年度実績	今回見通し	増減	中間決算 時見通し
売上高	12,986	14,300	+1,314 (+10.1%)	14,300
営業利益	811	920	+109 (+13.5%)	920
経常利益	768	870	+102 (+13.3%)	870
当期純利益	344	430	+86 (+25.0%)	430

想定為替レート(2006年1月～2006年3月) : 120円 / US \$、143円 / ユーロ
 想定原油価格(2006年1月～2006年3月) : US \$ 55 / B(ドバイFOB)

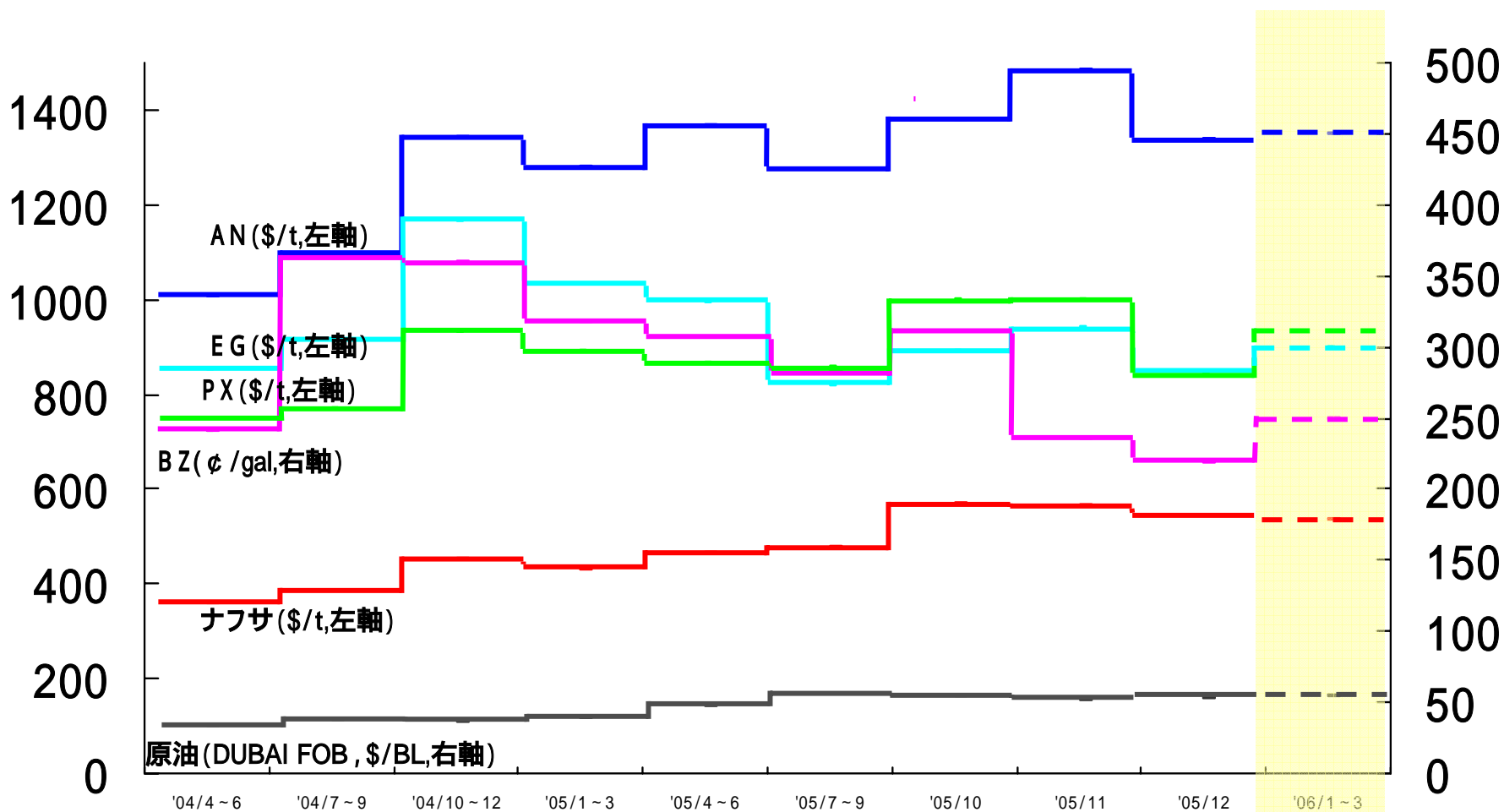
事業セグメント別業績見通し

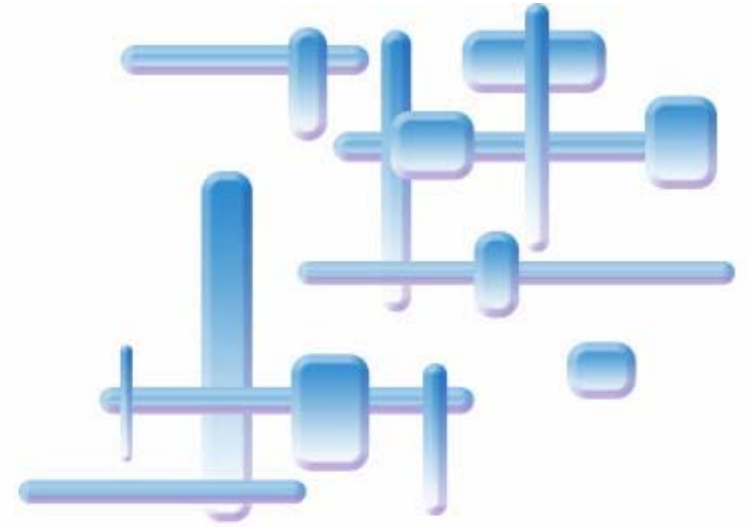
億円

	売上高			営業利益			特記事項
	前年度実績	今回見通し	増減	前年度実績	今回見通し	増減	
繊維	5,134	5,800	+666 (+13.0%)	209	210	+1 (+0.6%)	原燃料価格高騰の影響はあるも、価格転嫁・高採算品へのシフトを進めるとともに、海外子会社を中心に拡販を進め、増収増益の見込み。
プラスチック・ケミカル	3,004	3,300	+296 (+9.9%)	157	175	+18 (+11.8%)	自動車用樹脂及び包装材料用・工業材料用フィルムの拡販を進めるとともに、原燃料価格高騰分の価格転嫁を図り、増収増益の見込み。
情報通信材料・機器	2,191	2,400	+209 (+9.5%)	283	315	+32 (+11.4%)	IT関連需要の回復を受け、FPD関連フィルム、フィルム加工品、回路材料等の拡販により増収増益の見込み。
炭素繊維複合材料	447	500	+53 (+11.9%)	56	110	+54 (+96.6%)	航空機、産業、スポーツ全用途での旺盛な需要に加え、仏SOFICARの増設効果が寄与し、増収増益の見込み。
環境・エンジニアリング	1,487	1,600	+113 (+7.6%)	43	50	+7 (+16.4%)	水道機工の連結子会社化を主因に増収の見込み。エンジニアリング子会社及び建設子会社が好調に推移することを主因に増益の見込み。
ライセンスその他	723	700	-23 (-3.2%)	65	60	-5 (-7.2%)	前年度に子会社のホテル事業を譲渡したこと等により減益の見込み。
(内医薬・医療)	444	450	+6 (+1.5%)	29	30	+1 (+5.2%)	
連結	12,986	14,300	+1,314 (+10.1%)	811	920	+109 (+13.5%)	

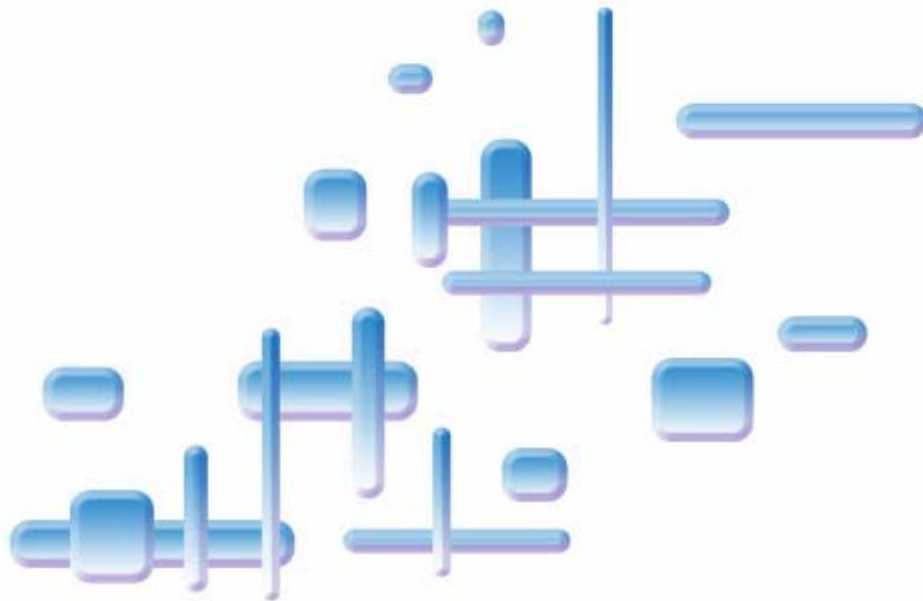
原料価格の見通し

主要原料の価格は、12月に弱含んだものの、1～3月は再び上昇に転ずる見込み。





・最近のトピックス



最近のトピックス(05/12～06/1)(1)

時期	トピックス	NT- の施策			
		先端材料 事業拡大	ナバ'-One 事業拡大	海外事業 拡大	事業構造 改革, NVC
12月	<p>東レとDNAチップ研究所 DNAチップ新製品で共同開発</p> <p>東レと株式会社DNAチップ研究所殿は、東レが開発した高性能DNAチップ基板とDNA研が独立行政法人産業技術総合研究所ゲノムファクトリー研究部門と協力し開発したオリゴDNA合成及び設計技術を組み合わせた高性能DNAチップの共同開発について合意。2006年4月に酵母の全遺伝子を搭載した遺伝研究用の網羅型チップを上市予定。</p>				
12月	<p>最先端半導体向けCMP研磨パッドを2006年1月から出荷開始</p> <p>ポリマーナノ分散技術を駆使することにより、最先端の12インチウェハプロセスに適する優れた性能を持ち、かつ、環境に優しいハロゲンフリーのCMP(Cheical Mechanical Polishing: 化学機械研磨)研磨パッドを開発。2006年1月から大手半導体メーカー向け出荷開始。</p>				
12月	<p>PAN系炭素繊維“トレカ”の欧州における生産増強</p> <p>炭素繊維複合材料の中長期的な需要拡大に対応するべく、“トレカ”の欧州における生産設備増強を決定。フランスの炭素繊維生産販売子会社であるソフィカール社(SOFICAR)に、航空機二次構造材および一般産業用途向け「細物炭素繊維」年産800トンの焼成設備を1系列増設し、2007年8月からの稼働開始を目指す。</p>				
12月	<p>ダイレクトメタノール形燃料電池の開発</p> <p>ダイレクトメタノール形燃料電池(DMFC)の主要部材である高分子電解質膜とそれを用いた膜電極複合体(MEA)の性能を実用化レベルまで向上させることに成功。従来のフッ素系電解質膜と比較して、伝導度を損なうことなくメタノール透過性(MCO)を1/10以下に低く抑えた炭化水素系電解質膜を世界で初めて開発。</p>				

最近のトピックス (05/12 ~ 06/1) (2)

時期	トピックス	NT- の施策			
		先端材料 事業拡大	ナンバ'-One 事業拡大	海外事業 拡大	事業構造 改革, NVC
12月	<p>癌の治療方向を高精度に診断できるDNAチップを開発</p> <p>東レと京都大学医学部及び薬学部は、このたび、東レが開発した高性能DNAチップ基板と京都大学の高度な医療・解析技術を組み合わせることにより、癌、非癌を95%以上の高い確率で判別できるだけでなく、治療方針に大きな影響を与える癌の性質(転移性、抗癌剤の有効性など)を高精度に判別できる診断チップの開発に成功。</p>				
12月	<p>フラーレンで光触媒コート材料の耐久性が2倍に向上</p> <p>東レと独立行政法人理化学研究所殿は、フラーレンを活用し、酸化チタン等の光触媒材料を用いた光触媒コート剤の性能・耐久性を2倍に向上させる技術開発に成功。</p>				
1月	<p>世界最大「PDP国内第4工場」を兵庫県に建設</p> <p>松下電器産業株式会社殿と東レは、PDPの新たな生産拠点として、両社の合弁会社である松下プラズマディスプレイ株式会社の第4工場を建設し、世界最大の量産体制を構築する。</p> <p>新工場は、投資額が1,800億円で、月産50万台、年産で600万台(42型換算)に上る世界最大の量産工場となる。2006年5月に着工、2007年7月に第一期の稼働を開始し、2008年度中のフル稼働を予定。</p>				
1月	<p>世界最高密度のIC実装用フィルム回路基板を開発</p> <p>配線のピッチが12μmという世界最高密度のIC実装用フィルム回路基板の開発に世界で初めて成功。当社瀬田工場内に月産100万個レベルの試験設備を設置し、2006年度の上市を目指す。現在、配線ピッチ20μmレベルの試作品を各ユーザーで評価中。</p>				

< 参考資料 >

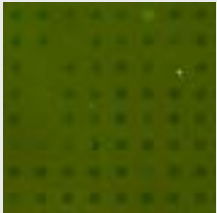
東レとDNAチップ研究所 DNAチップ新製品で共同開発

東レと株式会社DNAチップ研究所殿は、東レが開発した高性能DNAチップ基板とDNA研が独立行政法人産業技術総合研究所ゲノムファクトリー研究部門と協力し開発したオリゴDNA合成及び設計技術を組み合わせた高性能DNAチップの共同開発について合意。2006年4月に酵母の全遺伝子を搭載した遺伝研究用の網羅型チップを上市予定。

従来のDNAチップの課題

- ・シグナル<ノイズ
- ・検出ムラ
- ：シグナル強度・安定性低下

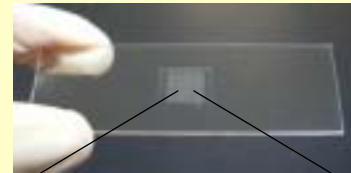
(ガラス基板/平面構造)



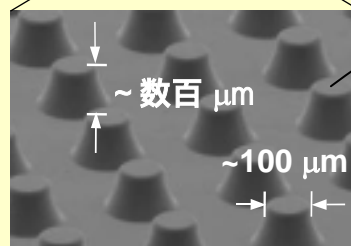
生検サンプル量：1mg

検出感度不十分
定量性 低
再現性 低

高性能DNAチップ



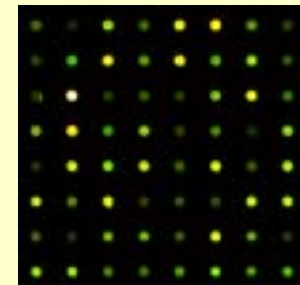
独自樹脂



検出用DNA

微細加工による
革新的構造の実現

- ・シグナル強度の向上
- ・ノイズの大幅低減



生検サンプル量：1mg

検出感度の飛躍的向上
(従来型チップの100倍)

高定量性

高再現性

高速検出
(従来型チップの10倍)

2006年4月に酵母の全遺伝子(約6,000)を搭載した網羅型チップ上市予定

2006年中にヒト遺伝子(1万~3万)を搭載した網羅型チップ上市予定

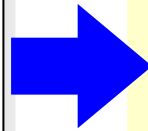
2008年迄に癌や生活習慣病をターゲットにした「検査・診断用途」のDNAチップ製品化を目指す

最先端半導体向けCMP研磨パッドを2006年1月から出荷開始

ポリマーナノ分散技術を駆使することにより、最先端の12インチウェハプロセスに適する優れた性能を持ち、かつ、環境に優しいハロゲンフリーのCMP (Chemical Mechanical Polishing: 化学機械研磨) 研磨パッドを開発。2006年1月から大手半導体メーカー向け出荷開始。

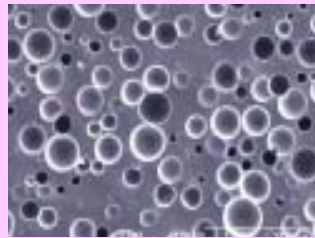
従来製品の問題点

- ・スラリーをはじめ研磨屑の凝集等による研磨傷(マイクロスクラッチ)の発生
- ・研磨シートの硬度や密度を自由に制御できない
- ・研磨シートに塩素を含む

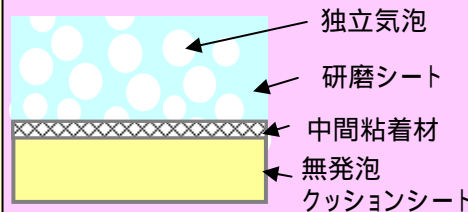


新製品の構造

化学発泡による微小独立気泡の形成(マイクロバルーン不使用)

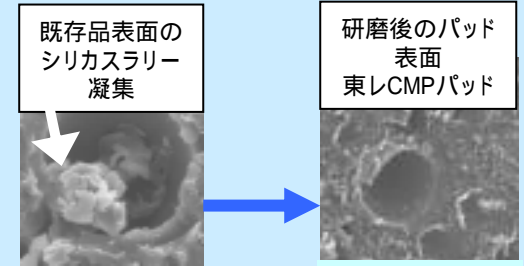


200 μm

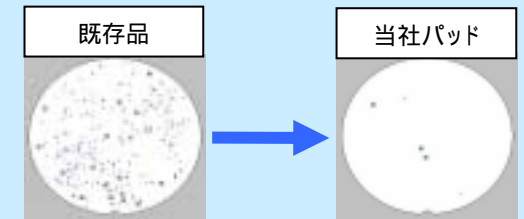


新製品の特長

・凝集異物の発生防止

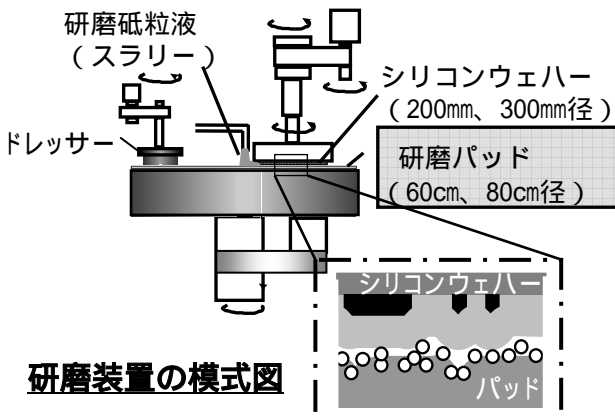


・マイクロスクラッチの低減



p-SiO₂ 膜 (STI プロセス) を900 研磨後、HF 水溶液にて9 min エッチング後に欠陥分析

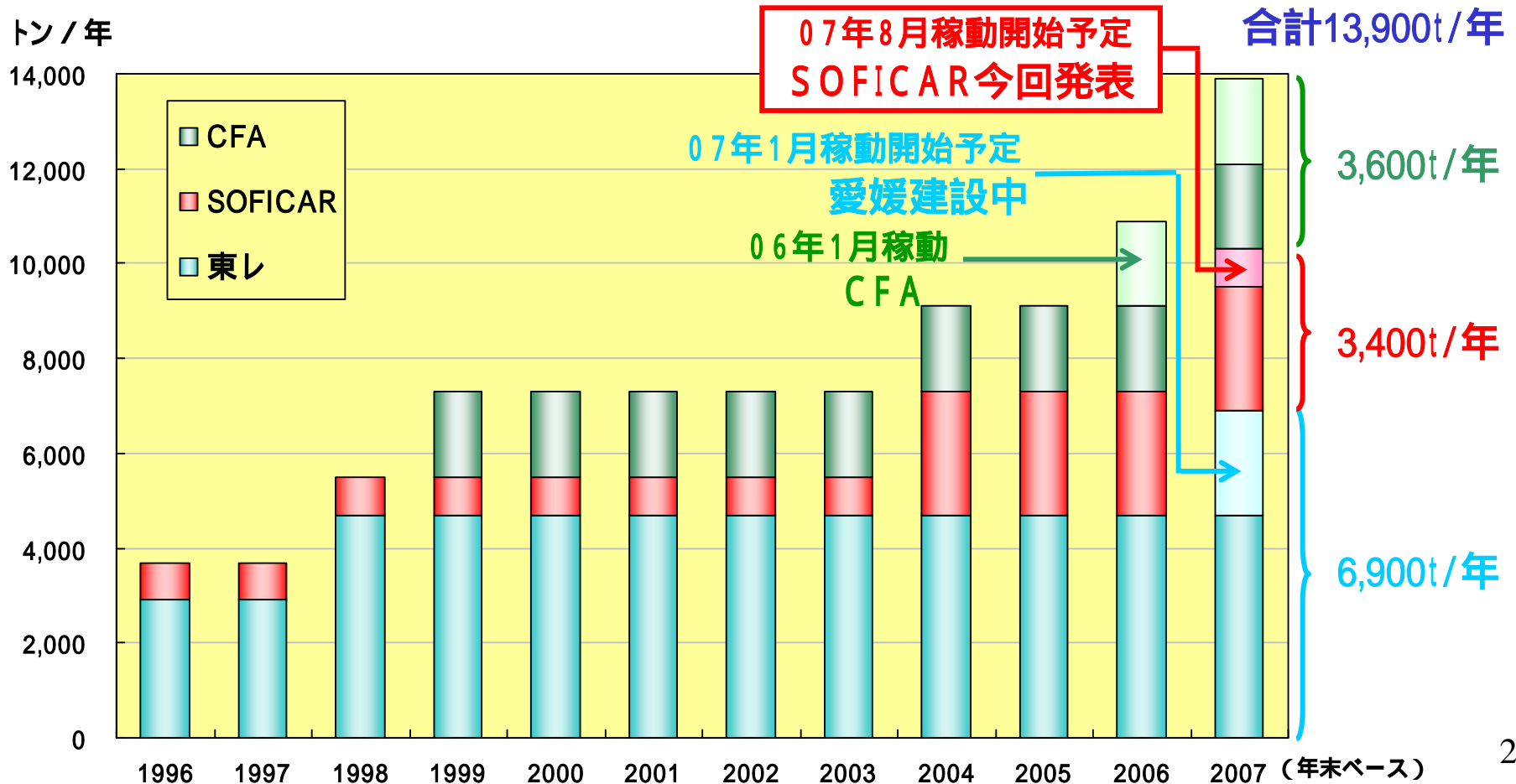
- ・研磨シートの硬度や密度の制御可能
- ・ハロゲンフリー化達成



PAN系炭素繊維“トレカ”複合材料の欧州における生産増強

炭素繊維複合材料の中長期的な需要拡大に対応すべく、“トレカ”の欧州における生産設備増強を決定。フランスの炭素繊維生産販売子会社であるソフィカル社(SOFICAR)に、航空機二次構造材および一般産業用途向け「細物炭素繊維」年産800トンの炭素繊維焼成設備を1系列増設し、2007年8月からの稼働開始を目指す。

東レグループの炭素繊維生産能力推移



ダイレクトメタノール形燃料電池の開発

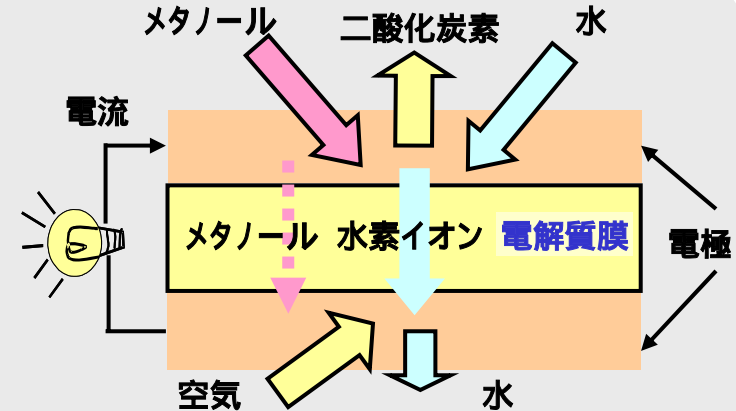
ダイレクトメタノール形燃料電池(DMFC)の主要部材である高分子電解質膜を開発。さらに、それを用いた膜電極複合体(MEA)の性能を実用化レベルまで向上させることに成功。従来のフッ素系電解質膜と比較して、伝導度を損なうことなくメタノール透過性(MCO)を1/10以下に低く抑えた炭化水素系電解質膜を世界で初めて開発。

従来のフッ素系電解質膜

水素イオンが透過する際、メタノールも同時に透過しやすい。



- ・発電に使用されないメタノールが燃料ロスとなる。
- ・透過したメタノールが酸化反応を起こし、発熱や発電性能低下の原因となる。

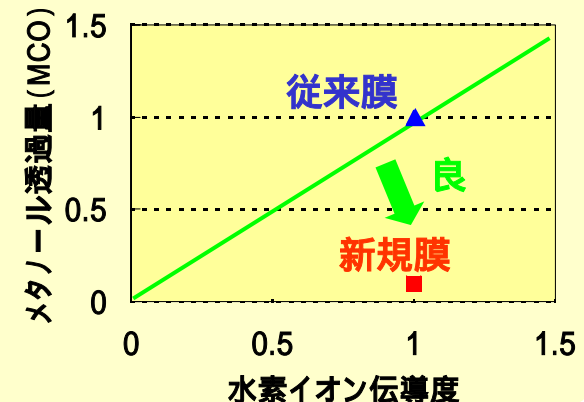


開発品の技術ポイント

従来の電解質膜を解析した結果、ポリマー中に存在する水が、水素イオン伝導だけでなく、メタノール透過も促進していることを見出す。



当社コア技術である高分子化学にナノ構造制御技術を融合、電解質膜のポリマー中の水がメタノール透過に影響せず、水素イオン伝導のみに寄与する電解質膜を世界で初めて開発。



ノートパソコンや携帯電話などのモバイル電子機器等の小型化、長時間使用が期待できる。

癌の治療方向を高精度に診断できるDNAチップを開発

東レと京都大学医学部及び薬学部は、このたび、東レが開発した高性能DNAチップ基板と京都大学の高度な医療・解析技術を組み合わせることにより、癌、非癌を95%以上の高い確率で判別できるだけでなく、治療方針に大きな影響を与える癌の性質(転移性、抗癌剤の有効性など)を高精度に判別できる診断チップの開発に成功。

東レ

超高感度DNAチップ基板



京都大学

- ・診断・医療現場からの高度な臨床情報
- ・高度な解析技術

癌を95%以上の確率で判別できる診断チップ

- ・超高感度DNAチップ基板を用いることにより、従来のチップの感度では不可能な僅か数mgの組織検体からの検査が可能

- ・再現性、定量性に優れた信頼性の高い診断が可能

食道癌

癌の判別確率 95%以上

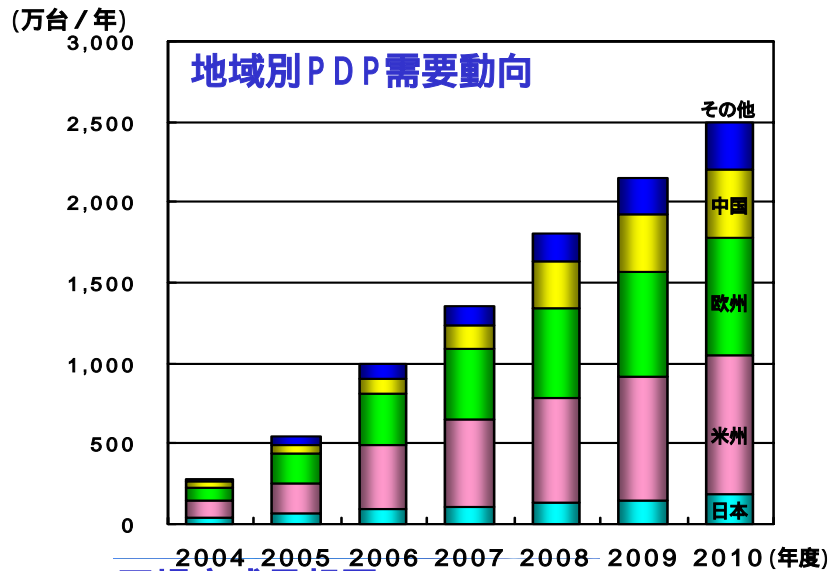
癌転移の予測確率 85%以上

腎癌

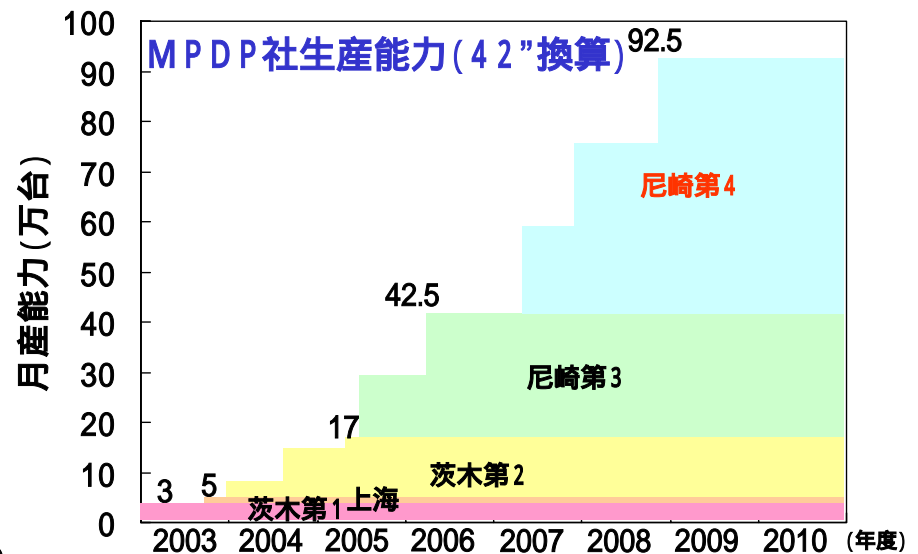
癌転移の予測確率 95%以上

世界最大「PDP国内第4工場」を兵庫県に建設

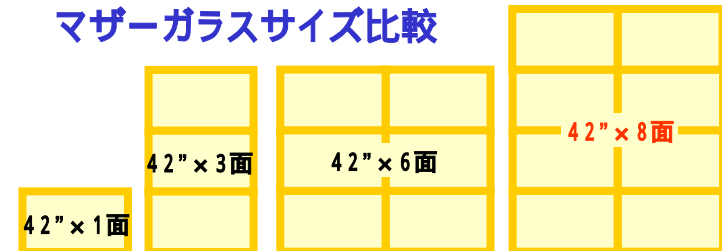
松下電器産業株式会社殿と東レは、PDPの新たな生産拠点として、両社の合併会社である松下プラズマディスプレイ株式会社(MPDP社)の第4工場を建設し、世界最大の量産体制を構築する。新工場は、投資額が1,800億円で、月産50万台、年産で600万台(42型換算)に上る世界最大の量産工場となる。2006年5月に着工、2007年7月に第一期の稼働を開始し、2008年度中のフル稼働を予定。



工場完成予想図



マザーガラスサイズ比較



茨木第1工場 茨木第2工場 尼崎第3工場 尼崎第4工場

世界最高密度のIC実装用フィルム回路基板を開発

配線のピッチが12 μm という世界最高密度のIC実装用フィルム回路基板の開発に世界で初めて成功。当社瀬田工場内に月産100万個レベルの試験設備を設置し、2006年度の上市を目指す。現在、配線ピッチ20 μm レベルの試作品を各ユーザーで評価中。

LCD駆動ICの接続ピッチのトレンド

年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ピッチ(μm)	35	30		25	20		15	10
寸法許容幅 (%)	± 0.04			± 0.02				± 0.01

従来COF技術

✦

新開発技術

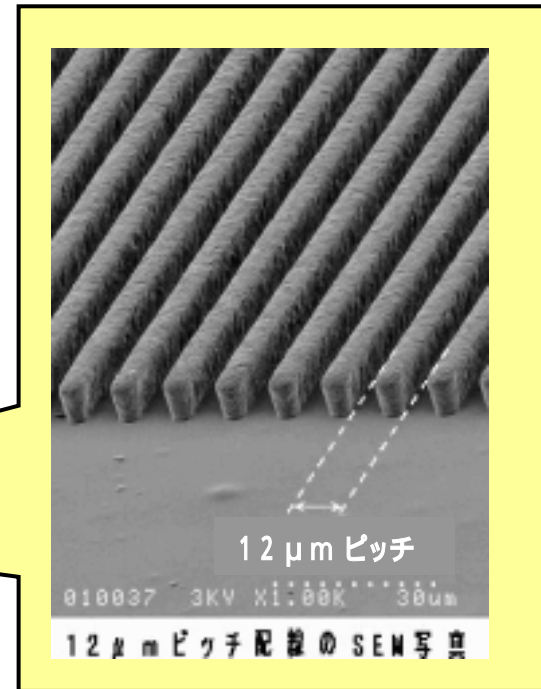
寸法安定性限界

新製品の特長

12 μm の微細ピッチ対応
 $\pm 0.001\%$ の位置精度

配線の狭ピッチ化による効果

回路基板の小型化によるIT機器の更なる小型化
 駆動ICの数を減少させることにより、コストダウンが可能



本資料中の2006年3月期の業績見通し及び事業計画・将来展望についての記述は、現時点における将来の経済環境予想等の仮定に基づいています。

本資料において当社の将来の業績を保証するものではありません。